

证券代码：688300

证券简称：联瑞新材

转债代码：118064

转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	广发证券、中欧基金、银河基金等共 6 家机构 10 人次，具体名单详见附件。	
时间	2026 年 5 月 21 日-5 月 22 日	
地点	联瑞新材会议室	
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：李欣安 证券事务专员：孟强	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分 公司基本情况介绍</p> <p>公司 42 年始终致力于功能性填料行业产品的研发、制造和销售，是国内行业龙头企业，拥有在功能性先进粉体材料领域独立自主的系统化知识产权，致力于成为全球领先的功能性先进粉体材料及应用方案供应商。公司是国家高新技术企业、国家首批专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军示范企业、国家知识产权优势企业、国家专利产业化样板企业。</p> <p>公司主要产品为功能性先进粉体材料，涵盖微米级和亚微米级角形粉体、微米级至纳米级球形粉体以及其他超微粒子和液态填料等，具有高纯度、高绝缘、低线性膨胀系数、高导热性、低介电损耗、低放射性等特点。产品广泛应用于芯片封装用环氧塑封材料（EMC）、液态塑封材料（LMC）、颗粒状</p>	

环氧塑封材料（GMC）、底部填充材料（UF）、电子电路基板(CCL)、积层胶膜（BF）、导热材料、特种胶黏剂、蜂窝陶瓷载体以及特高压电力电子制品、3D 打印材料、齿科材料等新兴业务。报告期内，公司持续聚焦高端芯片（AI、5G、HPC 等）封装、异构集成先进封装（Chiplet、HBM 等）、新一代高频高速覆铜板（M8、M9、M10 等）、新能源汽车用高导热材料、先进毫米波雷达等下游应用领域的先进技术，深化纳米级球形二氧化硅、高性能球形二氧化钛等功能性先进粉体材料的研究开发及应用推广，持续推出多种规格、低 CUT 点、表面修饰、Low α 微米/亚微米球形二氧化硅、低钠球形氧化铝粉，Low α 球形氧化铝、高频高速覆铜板用低损耗/超低损耗/极低损耗球形二氧化硅，新能源汽车用高导热微米/亚微米球形氧化铝等产品，持续加强功能性粉体材料的研究开发，技术储备二十余年的液相制备球形二氧化硅也正受益于高性能高速基板的发展机遇，产品认证速度不断加快。随着下游应用领域对高性能材料需求持续提升，公司产品结构有望进一步改善，从而推动经营质量不断提升。

2026 年一季度，公司实现营业收入 2.94 亿元，同比增长 23.16%；实现归属于上市公司股东净利润 0.72 亿元，同比增长 13.64%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 0.64 亿元，同比增长 8.46%。

第二部分 提问回答

问题 1：一季度利润增速与营收增速不匹配的原因。

答：2026 年第一季度，公司高性能产品占比进一步提升，推动了营收增长和经营质量改善，但受汇兑损益及可转债利息计提等因素影响，财务费用同比增加，影响了当期利润增速。

问题 2：高速基板领域公司的景气度感受。

答：从市场感受上看，越来越多的电子电路板厂商已经从使用 M4-M6 材料发展至使用 M7-M8 等高速材料，并向使用 M9、M10 等更低损耗等级持续发展，市场需求呈较快增长趋势，公司高性能高速基板用球形二氧化硅目前已在多家全球知名电子电路板领域厂商导入并实现销售，一季度公司相应产品呈较快增长趋势。

问题 3：公司产品是否有涨价。

答：在市场需求升级、出口退税政策变化等因素的影响下，公司一方面产品的价值量有所提高，另一方面部分产品价格有所提升。

问题 4：公司募投项目中高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目当前建设进度。

答：高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目分三期建设，一期项目已建设完毕，二期三期将按计划开展建设。

问题 5：公司未来营收结构变化的趋势。

答：从市场趋势来看，先进封装产业呈现加速渗透态势，2.5D/3D 等封装技术快速发展，推动具有精准大颗粒管控、更低 CUT 点、更加紧密填充、更低的放射性含量、高导热性的球形二氧化硅、球形氧化铝等功能性先进粉体材料市场需求；高性能高速基板领域，越来越多的电子电路板厂商已经从使用 M4-M6 材料发展至使用 M7-M8 等高速材料，更将向使用 M9、M10 及以上等级持续发展，以确保高速数据传输的稳定性和可靠性，高性能覆铜板正加速渗透，对于上游材料而言，需要选择具有较低 Df 的材料以保证在使用过程中减少信号传输时的衰减、时延，以提高信号完整性，在功能性填料选择上，对于粒径、介电损耗等性能指标要求更为严格，因此，球形二

	<p>氧化硅等为代表的高性能填料成为行业主流选择。导热材料上，消费电子、通讯、新能源汽车等领域对导热材料的需求量与日俱增，已成为导热材料的重要增长点，伴随高性能导热材料的需求日益提升，推动了作为导热填料的球形氧化铝、氮化物等市场需求的提高。公司紧抓下游应用领域市场升级的机遇，在优势领域提升市场份额的同时大力推进高性能产品研发与市场拓展，未来有望高性能产品营收占比进一步提高，产品结构持续优化。</p> <p>第三部分 总结</p> <p>通过会议问答的方式，公司解答了调研机构人员心中的问题以及调研人员对公司感兴趣的问题，调研机构人员对公司有了更多的了解和认识，对公司的产品表示认可，对公司未来的发展表示乐观，公司受到了调研机构人员的一致好评。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	详见附件

附件

参会机构及人员名单

序号	单位名称
1	银河基金管理有限公司
2	上海仙人掌私募基金管理合伙企业（有限合伙）
3	广发证券股份有限公司
4	中欧基金管理有限公司
5	中信保诚基金管理有限公司
6	泰康资产管理有限责任公司